



Tagesordnung

Thema: **03. Treffen des Arbeitskreises EcoReliability**
„Zuverlässige und nachhaltige Elektronik“

Datum: **09. Juli 2025 10:00 - 16:00 Uhr**

Ort: Präsenz (Fraunhofer IZM)

Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung
Herr Wagner, Frau Kolbinger, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr
Fachvortrag: Erfahrungen im Aufbau einer Open Cloud auf Basis von OCP und Refurbished Hardware - eine digital souveräne Alternative zu Hyperscale Clouds
Herr Streit, Scaleup Technologies Berlin
- 3 10:50 Uhr
Fachvortrag: Thermomechanische Zuverlässigkeit von Aluminium Bonddrähten leistungselektronischer Bauteile
Herr Kilian, Robert Bosch GmbH
- 4 11:30 Uhr
Pause
- 5 11:40 Uhr
Fachvortrag: Digitalisierung im Fertigungsumfeld: Was uns Fertigungsdaten über die Zuverlässigkeit sagen
Herr Dobs, Siemens AG
- 6 12:20
Fachvortrag: Randbedingungen für reproduzierbare und vergleichbare Betaungstest zum Nachweis der Migrationsbeständigkeit von Baugruppen
Herr Kandziora, Volkswagen AG
- 7 13:00
Pause



- 8 13:30
Impulsvortrag: LCA für Einsteiger/Fortgeschrittene
Chris Eckstein, Fraunhofer IZM
- 9 13:45
Workshop: Erstellung einer LCA
Chris Eckstein, Fraunhofer IZM
- 10 14:40
Pause
- 11 14:50
Labortour
- 12 15:40
Abschlussdiskussion

Ende der Veranstaltung gegen 16:00 Uhr

Vorläufig